

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 86v02.2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej dekarski KDT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KDT Pianoklej dekarski
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL KDT Pianoklej dekarski jest przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych:
  - płyt z wełny mineralnej (MW) o  $TR \geq 80$  kPa wg PN-EN 13162;
  - płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) wg PN-EN 13163;
  - gładkich płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) wg PN-EN 13164;
  - gładkich płyt poliizocyjanurowych (PIR) wg PN-EN 13165,
  - płyt poliizocyjanurowych (PIR) z welonem aluminiowym wg PN-EN 13165;
  - gładkich płyt poliuretanowych (PUR) wg PN-EN 13165do podłoży mineralnych, np. betonowych, ceramicznych przy wykonywaniu zewnętrznych systemów izolacji cieplnej ETICS, w tym przy wykonywaniu drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych oraz przy wykonywaniu ociepleń dachów płaskich.  
Wszystkie płyty mogą być mocowane do podłoży pokrytych papą, drewnianych i z płyt OSB oraz blaszanych ocynkowanych. Dodatkowo płyty z EPS i XPS mogą być mocowane do mineralnych warstw zbrojących, tynków mineralnych, silikonowych i akrylowych. Klej poliuretanowy jest również przeznaczony do mocowania płyt EPS i XPS do podłoży z hydroizolacją bitumiczną ( w podziemnych częściach budynków).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Selenia S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nr 3
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT-2020/0109 wydanie 3  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr akredytacji AC 008, nr certyfikatu 008-UWB-164

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Stopień ekspansji (przyrost wysokości), mm                                                                                                                                                                                | ≤ 3,0                            |       |
| Wytrzymałość na ścinanie, kPa                                                                                                                                                                                             | ≥ 140                            |       |
| Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa                                                                                                                                                                         | ≥ 400                            |       |
| <b>Płyty z wełny mineralnej (MW)</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |       |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta <b>MW</b> – spoina klejowa 8 mm – beton, MPa, w:                                                                                                  |                                  |       |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.                                                                                                                                                                     | ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie  |       |
| - temperaturze -5 °C                                                                                                                                                                                                      | ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie  |       |
| - temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                          | ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie  |       |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni w temperaturze 0 °C połączenia: płyta <b>MW</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa                                  | ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie  |       |
| <b>Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS)</b>                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta <b>EPS</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w:                 |                                  |       |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.                                                                                                                                                                     | ≥ 0,08                           |       |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm                                                                                                                            | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze 0 °C                                                                                                                                                                                                       | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                         | ≥ 0,08                           |       |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta <b>EPS</b> – spoina klejowa 8 mm- podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy), MPa, w:                   |                                  |       |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.                                                                                                                                                                     | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze -5 °C                                                                                                                                                                                                      | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze -5 °C przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm                                                                                                                                                             | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                         | ≥ 0,08                           |       |
| <b>Gładkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)</b>                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>XPS</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w: |                                  |       |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.                                                                                                                                                                     | ≥ 0,08                           |       |
| - temperaturze 0 °C                                                                                                                                                                                                       | ≥ 0,08                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny 15 mm                                                                                                                                                  | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                                            | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>XPS</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy) , MPa, w:                    |        |  |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze - 5 °C                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze - 5 °C przy grubości spoiny 15 mm                                                                                                                                                                                             | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                                            | ≥ 0,08 |  |
| <b>Gładkie płyty poliizocyanurowe PIR</b>                                                                                                                                                                                                    |        |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PIR</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:                                              |        |  |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - warunkach laboratoryjnych przy grubości spoiny 15 mm                                                                                                                                                                                       | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 0 °C                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                                            | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PIR</b> - w temperaturze 0 °C i przy spoinie klejowej 15 mm – podłoże (beton, drewno, blacha ocynkowana), MPa, po czasie otwartym 1 min.          | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PIR</b> – spoina klejowa – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy) w temperaturze -5 °C, MPa         |        |  |
| - spoina klejowa 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - spoina klejowa 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 0,08 |  |
| <b>Płyty poliizocyanurowe PIR z welonem aluminiowym</b>                                                                                                                                                                                      |        |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PIR z welonem aluminiowym</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:                        |        |  |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 0 °C                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                                            | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PIR z welonem aluminiowym</b> – spoina klejowa - podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy) w temperaturze - 5 °C, MPa |        |  |
| - spoina klejowa 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 0,08 |  |
| - spoina klejowa 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 0,08 |  |
| <b>Gładkie płyty poliuretanowe (PUR)</b>                                                                                                                                                                                                     |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PUR</b> – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:                                       |        |  |
| - warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.                                                                                                                                                                                 | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 0 °C                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 0,08 |  |
| - temperaturze 35 °C i wilgotności względnej 30 %                                                                                                                                                                                     | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PUR</b> – w temperaturze 0 °C i przy spoinie klejowej 15 mm – podłoże (beton, papa), MPa, po czasie otwartym 1 min.                        | ≥ 0,08 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna <b>PUR</b> – spoina klejowa - podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk akrylowy, tynk silikonowy) w temperaturze - 5 °C, MPa |        |  |
| - spoina klejowa 8 mm                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 0,08 |  |
| - spoina klejowa 15 mm                                                                                                                                                                                                                | ≥ 0,08 |  |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Renata Lechoniewicz, R&D Certification Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

24.05.2024, Wrocław